

SD23M101 通用传感器信号调理与变送输出专用芯片

概述

SD23M101 是用于阻式或电压型传感器的信号调理与变送器输出专用芯片,特别适合阻式或者电压型传感器,如扩散硅压力传感器,陶瓷压力传感器,单晶硅压力传感器,溅射薄膜,应变式压力传感器,蓝宝石压力传感器,玻璃微溶等压力传感器,热电偶,RTD,NTC等温度传感器,实现信号调理与变送输出。内部集成24位主信号测量ADC,支持EMI检测,24位辅助温度测量ADC,双路恒流源,恒压源,满足传感器测量与温补需求;集成16位DAC,可实现4-20mA/0-2.5V/0-5V/0-10V输出,并允许输出超量程10%;灵活的数字通信接口,如IIC、SPI、UART、PWM等,专有的OWI通信协议可借助电源实现载波通信,简化生产过程。内置32位MCU,集成3P3T、5P5T、7P7T等传感器校准算法,可很好的保证测量精度,且校准数据保存于内部EEPROM。独有的温补功能,可借助内部ADC与温度传感器实现温补,使结果的温漂更小,提高了产品的可靠性。

SD23M101 高度集成,灵活的接口方案,仅需最少的外部电路,即可实现通用变送器板 卡的设计与校准。

指标介绍

- 两个独立的模拟前端(AFE)信号链,每个链路包括:
 - ■低噪声可编程增益放大器
 - 24 位 Σ △ 模数转换器(ADC)
 - 可编程 ADC 输出速率
 - 50 Hz/60 Hz 同步噪声抑制
 - EMI 检测功能
- 内置可编程增益放大器的 16 位 DAC, 支持输出:
 - ■三线制比例电压和绝对电压输出,允许超量程 10%
 - 两线制 4-20mA 电流输出
- 内置高压电源管理模块,支持 6.5~40V 宽电压供电
- 可编程电压源激励
- 两路可编程匹配电流源激励
- 内置高线性度温度传感器,也可使用外部温度传感器
- 内置低温漂基准,温漂典型值 10ppm/℃
- 内置 32 位 MCU, 集成传感器校准算法
- 支持 IIC、SPI、OWI 接口
- 外部 JFET 控制器
- 典型功耗: 2.5mA

- 封装形式: QFN32
- 工作温度范围: -40℃~125℃

芯片照片



图 1 SD23M101

典型应用

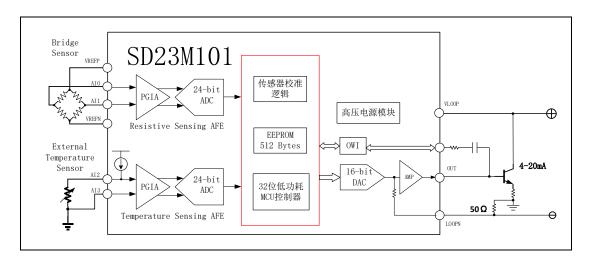


图 2 4-20mA 输出型压力变送器典型应用框图

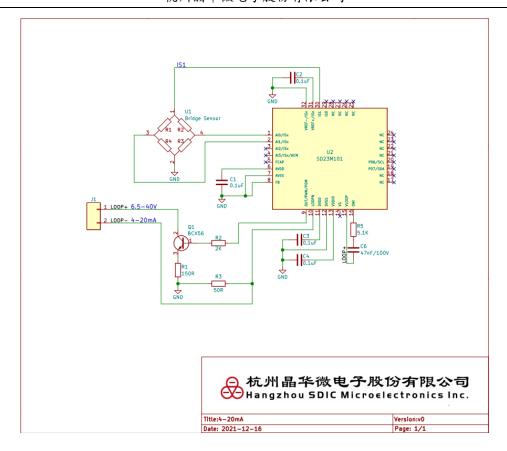


图 3 4-20mA 变送板参考电路

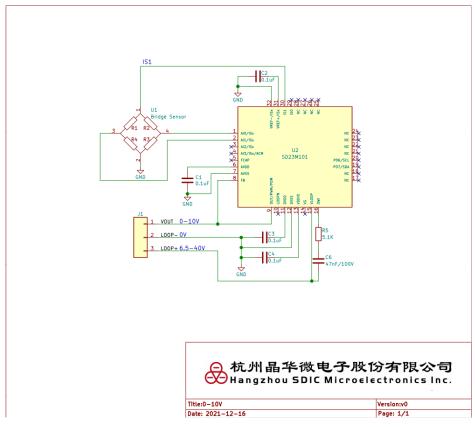


图 40-10V 变送板参考电路

方案优势

- 1, 芯片采用高压工艺, 芯片可直接环路高电压供电;
- 2, 得益于高压工艺的优势,可直接输出 0-10V 电压信号;
- 3, 支持 OWI 通信,可借助电源线实现载波通信,方便产品调试;
- 4, 内部集成温度传感器,并集成温补功能,使芯片的温漂性能更好;
- 5, 集成度高, 只需很少的外围器件, 即可实现整套变送器方案;
- 6, 内部集成 MCU, 支持方案定制;